

FUJIKURA COMPOSITES

シリコーンブランケット

ファインライン印刷技術

For Printed Electronics

近年、新聞や雑誌を印刷するように、印刷技術を用いて電子回路等のエレクトロニクス製品を大量かつ低コストで製造する次世代の技術として期待されています。

◆グラビアオフセット印刷

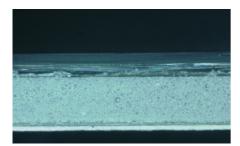
グラビア印刷とオフセット印刷を組合せた印刷方法です。

- (1)ドクターブレードによりペーストを彫刻したパターン(グラビア版)の中に**充填**します。
- ②凹版上でブランケット胴を転がすとペーストがブランケット胴上に受理(オフ)します。
- ③ワークの上でブランケット胴を転がすとインキが転写(セット)されます。

◆特徴

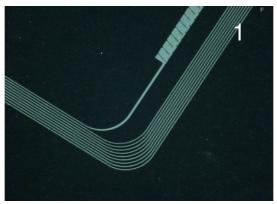
- ①版より受理したペーストを100%ワークへ転写できます。
- ②表面の平滑さ:ブランケットの表面を特殊加工し、微少領域での表面粗さはRaく数10nmです。
- ③界面特性のコントロール(受理転写のバランス制御)で、膜厚均一性の高い印刷が可能です。

標準仕様(断面)



タイプ: #700-STD 表面ゴム: シリコーンゴム 臨界表面張力 γ c =約22 dyne/cm

印刷例(社内印刷サンプル)







1:銀配線 ファインライン L/S=30 μ m/30 μ m(50倍)

2:銀配線 ファインライン L/S=30 μ m/30 μ m(100倍)

3:銀配線 メタルメッシュ L/P=7μm/300μm(175倍)

◆総厚:1.7mm、2.3mm

◆テスト印刷:受託加工可能。

◆詳細仕様等:お問い合わせ下さい。

藤倉ゴム工業株式会社

営業本部 営業開発室 〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明イーストタワー10F TEL 03-3527-8434 kaihatsu@fc.fujikura.co.jp

FUJIKURA COMPOSITES

銀ペーストご提供:藤倉化成株式会社様